



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 板对板

位数: 15

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

线缆端接方法: 焊接孔

双位置数量: 15

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|--------|
| 连接器系统 | 板对板 |
| 连接器和壳体类型 | 母端, 母端 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

| | |
|-----------|----|
| 位数 | 15 |
| 双位置数量 | 15 |
| 行数 | 2 |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

主体特性

| | |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 绿色 |
|--------|----|

接触件特性

| | |
|------------------|----------------------------|
| 壳体内部的端子定位力 | 带有 |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 2.54 μ m[100 μ in] |
| 端子类型 | 插座 |

| | |
|--------------|--------|
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .76 μm |
|--------------|--------|

| | |
|-----------|---|
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
|-----------|---|

| | |
|--------------------|----|
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光 |
|--------------------|----|

| | |
|--------|---|
| 端子底板材料 | 镍 |
|--------|---|

| | |
|----------------|---|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
|----------------|---|

| | |
|------|-----|
| 端子基材 | 磷青铜 |
|------|-----|

| | |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 5 A |
|-------------|-----|

端接特性

| | |
|------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.81 mm[.15 in] |
|------------|-----------------|

| | |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

| | |
|--------|-----|
| 线缆端接方法 | 焊接孔 |
|--------|-----|

机械附件

| | |
|------|----|
| 接合固定 | 不带 |
|------|----|

| | |
|------|----|
| 接合对准 | 不带 |
|------|----|

| | |
|--------------|-----|
| 壳体内部的端子定位器类型 | 锁定枪 |
|--------------|-----|

| | |
|----------|----|
| PCB 安装对准 | 不带 |
|----------|----|

| | |
|----------|----|
| PCB 安装固定 | 带有 |
|----------|----|

| | |
|------------|-----|
| PCB 安装固定类型 | 安装耳 |
|------------|-----|

| | |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

| | |
|---------|------------------|
| 中心线（间距） | 3.96 mm[.156 in] |
|---------|------------------|

| | |
|------|--------|
| 外壳材料 | 玻璃填充聚酯 |
|------|--------|

尺寸

| | |
|------|------------------|
| 卡槽深度 | 7.49 mm[.295 in] |
|------|------------------|

| | |
|-------|------------------|
| 连接器高度 | 11.68 mm[.46 in] |
|-------|------------------|

| | |
|-----|----------------|
| 行间距 | 5.08 mm[.2 in] |
|-----|----------------|

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装数量 | 120 |
|------|-----|

封装方法

Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

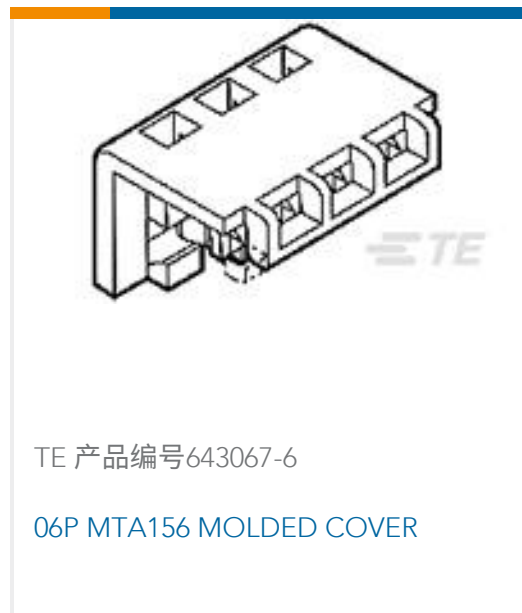
| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合且适用豁免 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | <p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (13% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p> |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 240°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-530655-4_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-530655-4_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-530655-4_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[REPLACING CONTACTS IN AMP LOW PROFILE EDGE CONNECTORS](#)

英文版本